

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild























Hochtemperaturfeste, 90° abgewinkelte, offene Stiftleiste. Verpackung in Box oder Tape. Im Tape mit 1,5 mm Lötstift optimiert für die Automatenbestückung. Lötstift 3,2 mm für Reflow- und Wellenlötanwendungen geeignet. Die Stiftleisten sind beschriftbar und können kodiert werden. HC = High Current.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (I): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape
BestNr.	<u>1868290000</u>
Тур	SL-SMT 5.08HC/06/90 3.2SN BK RL
GTIN (EAN)	4032248439270
VPE	350 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 400 V / 27.5 A
	UL: 300 V / 18.5 A
Verpackung	Tape



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0,472 inch
Höhe	11,7 mm	Höhe (inch)	0,461 inch
Höhe niedrigstbauend	8,5 mm	Breite	30,48 mm
Breite (inch)	1,2 inch	Nettogewicht	3,551 g

Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie	Anschlussart	
	BL/SL 5.08		Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte	THT/THR-Lötanschluss	Raster in mm (P)	5,08 mm
Raster in Zoll (P)	0,2 "	Abgangswinkel	90°
Polzahl	6	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Lötstiftlänge (I)	3,2 mm	Lötstiftlänge-Toleranz	0 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen	d = 1,2 mm, oktogonal	Bestückungsloch-Durchmesser (D)	1,4 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz		L1 in mm	
(D)	+ 0,1 mm		25,4 mm
L1 in Zoll	1 "	Anzahl Reihen	1
Polreihenzahl		Berührungsschutz nach DIN VDE 57	fingers. ungest./ handrü-
	1	106	ckens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20 gesteckt/ IP 10 un-	Schutzart	
	gesteckt		IP20
Durchgangswiderstand	≤5 mΩ	Kodierbar	Ja
Steckkraft/Pol, max.	9 N	Ziehkraft/Pol, max.	7 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP GF	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	Illa
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche		Schichtaufbau - Lötanschluss	13 μm Ni / 24 μm Sn
	verzinnt		matt
Schichtaufbau - Steckkontakt	13 μm Ni / 24 μm Sn	Lagertemperatur, min.	
	matt		-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-30 °C
Temperaturbereich Montage, max.	100 °C		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
	IEC 60664-1, IEC 61984	(Tu=20°C)	27,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsstrom, min. Polzahl	
(Tu=20°C)	19 A	(Tu=40°C)	24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsspannung bei Überspan-	
(Tu=40°C)	16,5 A	nungsk./Verschmutzungsgrad II/2	400 V
Bemessungsspannung bei Überspan-		Bemessungsspannung bei Überspan-	
nungsk./Verschmutzungsgrad III/2	320 V	nungsk./Verschmutzungsgrad III/3	250 V
Bemessungsstoßspannung bei Über-		Bemessungsstoßspannung bei Über-	
spannungsk./Verschmutzungsgrad II/2	4 kV	spannungsk./Verschmutzungsgrad III/2	2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Über-			
spannungsk./Verschmutzungsgrad III/3	3 4 kV		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA)	300 V	Nennspannung (Use group D / CSA)	300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)	18,5 A	Nennstrom (Use group D / CSA)	18,5 A

Nenndaten nach UL 1059

Institut (UR)		Zertifikat-Nr. (UR)
	1.5	

			E60693
Nennspannung (Use group B / UL	300 V	Nennspannung (Use group D / UL	300 V
1059)	300 V	1059)	300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)	18,5 A	Nennstrom (Use group D / UL 1059)	10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximal- werte, Details siehe Zulas- sungs-Zertifikat.		

Verpackungen

ESD Level Verpackung	statisch ableitfähig	Verpackung	Tape
VPE Länge	330 mm	VPE Breite	330 mm
VPE Höhe	50 mm	Tapetiefe (T2)	12,8 mm
Tapebreite (W)	44 mm	Tape-Taschentiefe (KO)	12,3 mm
Tape-Taschenhöhe (A0)	12,3 mm	Tape-Taschenbreite (B0)	30,58 mm
Tape-Taschenabstand (P1)	16 mm	Tape-Lochabstand (E)	1,75 mm
Tape-Taschenabstand (F)	20,2 mm	Tape-Spulendurchmesser Ø (A)	330 mm
Oberflächenwiderstand	$B_s = 10^9 - 10^{12} O$		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Wi	chtic	ıer Hi	nweis
vvi	CHILIT	G1 111	1144612

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
	Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
	• Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm
	• Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole
	• Zeichnungsangabe P = Raster
	 Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
	 OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
	 Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %. 36 Monate

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E60693

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Produktänderungsmitteilung	PCN 2015 208 PL30X SC-SMT SL SMT 3.xx 5.xx neue Tapeverpackung Step 4 DE
	PCN 2015 208 PL30X SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_new_Tape_Packaging_Step_4_EN
	Changeover to ESD bags for "Tape on Reel" products
	Umstellung auf ESD-Beutel bei "Tape on Reel" Produkten
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL DRIVES EN
	<u>FL DRIVES DE</u>
Whitepaper surface mount technology	Download Whitepaper



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

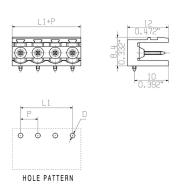
www.weidmueller.com

Zeichnungen

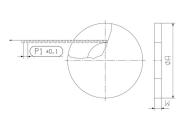
Produktbild



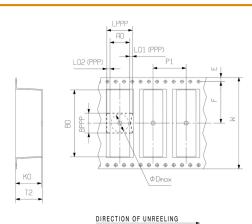
Maßbild



Maßbild



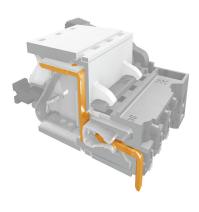
Maßbild



Anwendungsbeispiel



Produktvorteil



Sichere Leistungsübertragung Bewährte Eigenschaften



Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.





Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt ≤ +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste 'aktiviert'. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.